



第一屆金桂獎之「卓越市值營收獎」

頤邦科技(股)公司上櫃日期：2002.01.31



【吳非艱小檔案】

- ▶ 學歷：台大物理系、美國匹茲堡大學電機及物理碩士
- ▶ 現職：頤邦科技(股)公司董事長
- ▶ 經歷：Digital Equipment Corporation 副總經理、Micro Robotics Systems Corp 副總經理等職
- ▶ 興趣：打籃球

改寫規模創造優勢的鐵則

打小白球（高爾夫球）是企業家們很常見的一項運動，但對吳非艱來說，打籃球才是他的最愛。當時吳非艱念台大物理系時，就與台大籃球校隊結緣，所以台大畢業後一直到出國唸書，打籃球一直是吳非艱最愛的運動項目之一。待吳非艱回台創立了頤邦科技，他還是維持打籃球的運動習慣。運動之外，吳非艱也是頤邦最佳代言人，會親自參加外資投資論壇、法說會等活動，將頤邦的營運成績及未來成長計劃，親自向外界說分明。

在創設頤邦之前，吳非艱在美國任職於半導體設備廠，對於半導體技術和製程相當熟悉，因為被工研院聘任而回國，但僅待了一年就決定自行創業，1997 年頤邦因而誕生。頤邦成立之初，恰逢遇上台灣面板產業進入高速成長期，才 3 年的時間，整個市場上就出現福祿、悠立、力泓、華宸…等數家競爭對手。吳非艱深知要跟同業拉開距離，不能只是在財務及管理上突圍而已，所以他運用了過去在設備廠的經驗，開始自行研發設備。頤邦在 2002 年掛牌上櫃後，可以開始向市場籌措資金，吳非艱瞭解要在 LCD 驅動 IC 封測市場坐穩一席之地，只能靠併購方式壯大自己，才有辦法挑戰龍頭大廠日本卡西歐及韓國三星。

2004 年順利合併華宸，讓頤邦取得測試產能，並順利躍居全球金凸塊龍頭地位，也引進聯電及鴻海等股東；在 2006 年又再度合併華暘，藉以取得玻璃覆晶封裝(COG)及切割、研磨產能；2009 年頤邦併購飛信後，

每月在薄膜覆晶(COF)產能超過一億二千五百萬顆，超越原有市場一哥南茂的六千萬顆產能，而頌邦在玻璃覆晶技術的月產能為一億一千五百萬顆，穩坐全球驅動 IC 封裝市占率王座。在半導體產業，規模創造優勢是幾乎不變的鐵則，但驅動 IC 封測廠頌邦科技，卻改寫了這條規則。

吳非艱選擇的是個變化快速的市場，以金凸塊封裝所需的金為例，1997年，金成本只占頌邦成本的5%，如今，卻占到超過成本的50%，對手殺價、技術改變帶來的挑戰，更是隨時發生。面對種種挑戰，吳非艱體認到在封測產業裡「Me Too」的思維，無法創造公司的競爭優勢，「今天能讓公司做出最好表現的方法，到了明天，可能就讓公司走下坡」。

每當有空的時候，吳非艱就會打開報告，從紙上模擬推算數字背後的意義，一發現異常，隨時改變做法，嚴格控制成本。這套紙上模擬法，是吳非艱創業的成功心法，每次遇到問題，詳列每個問題，再一一列出可能的解答，和一旦採用後，會產生的結果。吳非艱認為管理可以區分為兩部分，第一部分是永恆不變的，例如對誠信的堅持、持續降低成本；另一部分則應該隨著時空而改變，像市場策略、技術的演進。靠著不斷蒐集資訊，分析資訊，才能即時快速因應，做出關鍵的決策。



頌邦科技(股)公司

成立日期：1997.07.02

主要經營業務：金凸塊(GOLD BUMPING)/錫鉛凸塊(SOLD BUMPING)/晶圓測試(CP)/捲帶軟板封裝(TCP)/捲帶式薄膜覆晶(COF)/玻璃覆晶封裝(COG)

地址：新竹市新竹科學工業園區力行五路三號

電話：03-567-8788

▶ 資料來源：

理財周刊585期/產業人物-研發新IC驅動凸塊 頌邦獲利高成長/2011.11.9

自由時報/吳非艱、李金恭哥倆好，從事業合作到公益/2011.3.7

工商時報/人物側寫-另類董事長 55歲了…還在打籃球 /2010.3.29

商業周刊/頌邦打破半導體鐵律 扳倒老大哥/2010.5.31

經濟日報/頌邦董座吳非艱，數字管理高手/2010.3.22

公開資訊觀測站

▶ 照片出處：理財周刊 585 期